

晋政文〔2022〕15号

## 晋江市人民政府关于进一步加快培育 集成电路全产业链的若干意见

各镇人民政府、街道办事处，经济开发区管委会，市直各单位：

为贯彻落实福建省第十一次党代会、泉州市第十三次党代会、晋江市第十四次党代会精神，加快数字化转型发展，加速打造具有全国影响的千亿数字产业集群，更加积极融入海峡两岸集成电路产业合作试验区，推动我市集成电路产业高质量跃升发展，特制定本意见。

### 一、支持方向

为营造我市集成电路产业发展的良好生态，重点支持和鼓励集成电路设计、制造、封测、装备、材料以及应用终端、创新服务平台等业态的企业、项目、机构、人才入驻，支持集成电路企业做大做强，集聚壮大集成电路产业人才队伍。

## 二、招商扶持政策

(一)按“三园一区”布局规划建设晋江市集成电路产业园区，根据功能定位分类保障集成电路企业发展空间。

(二)对总投资超1亿元的新建集成电路生产性及配套项目，按其新购置生产设备金额的10%给予补助，累计最高1000万元；对总投资超2000万元且实际到资满一年的集成电路设计项目，按实际到资额的10%予以补助，累计最高500万元。(责任单位：集成电路筹备组、工信局)

属于下列情形的，可采取“一企一议”方式予以支持：总投资超5亿元的新建集成电路生产性及配套项目；总投资超5000万元的集成电路设计项目；总投资超1亿元的行业领先或细分领域领先企业，且能够填补集成电路产业链缺失环节或薄弱环节的项目；总投资超5亿元的集成电路产业园区开发建设、招商运营项目。(责任单位：集成电路筹备组)

(三)对新引进的集成电路产业链企业，采取事前备案、先缴后补的方式给予场地租金补助，补助标准不超过企业实际支付的租金标准。补助标准如下：

1. 生产性及配套企业：对租用集成电路产业园区内（含集成电路小微工业园）生产场地的，前三年按实际租金的100%给予补助，第四、第五年按实际租金的50%给予补助；对租用集成电路产业园区外生产场地的，前三年按8元/平方米，第四、第五年按4元/平方米给予补助。以上租金补助面积累计最高1500平方米。

2. 设计类企业：对租用集成电路产业园区内（含设计园、集成电路小微工业园）研发、办公场地的，前三年按实际租金的100%给予补助，第四、第五年按实际租金的50%给予补助；

对租用集成电路产业园区外研发、办公场地的，前三年按 20 元/平方米、第四、第五年按 10 元/平方米给予补助。以上租金补助面积累计最高 500 平方米。（责任单位：集成电路筹备组）

（四）对新增用地或者租用厂房面积不少于 2000 平方米的新建集成电路生产性及配套项目，需租用临时办公场所的，采取事前备案、先缴后补的方式给予租金补助，补助标准最高 30 元/平方米，补助面积最高 100 平方米，补助时间最长 12 个月。补助标准不超过企业实际支付的租金标准。（责任单位：集成电路筹备组）

（五）对新引进的集成电路生产性及配套企业的万级无尘车间按 600 元/平方米、千级无尘车间按 1000 元/平方米、百级及以上等级无尘车间按 2500 元/平方米给予装修补助，单个企业最高补助 500 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（六）支持集成电路企业拓展国内外市场，对参加国内外专业展会的集成电路企业（当年度产品销售收入 1 亿元以上）给予展位费、特装搭建等费用 50% 的补助，单次最高补助 25 万元，单个企业每年最高补助 50 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（七）建设标准厂房，以出租或出售方式提供给集成电路企业，保障项目快速开工建设需求。对引进的集成电路生产性及配套企业，实行“单一窗口”服务保障。（责任单位：集成电路筹备组、福建省晋江产业发展投资集团有限公司）

### 三、投融资激励政策

（一）鼓励企业自主开展股权融资，对集成电路企业获得首轮风险投资或天使投资且投资期限一年以上的（投资机构需经注册备案），按照投资机构实际到位投资总额的 10% 给予该企业一次性奖励，单个企业最高奖励 100 万元。（责任单位：集成电

路筹备组)

(二)对年度销售总额较其上一年度销售总额增长10%以上、且获得一年期以上银行贷款的集成电路企业，分别按银行同期基准利率的30%、50%给予生产性企业、设计企业贴息支持，获得贷款利率为基准下浮的企业以实际贷款利率的30%、50%给予生产性企业、设计企业贴息支持，单个企业最高200万元。(责任单位：集成电路筹备组)

(三)鼓励集成电路企业通过境内外上市、场外市场挂牌等直接融资方式募集资金；组织保荐机构开展企业上市辅导。对进入上市程序的企业，按照有关政策文件给予工作支持以及相应奖励，并对在科创板、北交所成功上市企业追加奖励50万元。(责任单位：集成电路筹备组、金融局)

(四)对成功并购晋江市以外集成电路项目(非股权关联企业)、且并购规模在1亿元以上、10亿元以下的实体企业，按并购方对目标企业的实际现金购买价格、承担债务金额或目标企业净资产作价入股金额的5%给予奖励。并购规模达10亿元及以上的可采取“一企一议”方式予以支持。对并购过程中发生的评估、审计、法律顾问等前期费用，按30%给予补助，最高补助300万元。(责任单位：集成电路筹备组)

#### 四、科研鼓励政策

(一)鼓励集成电路企业联合高校科研院所建设各类集成电路公共服务平台，为集成电路企业提供前沿技术和科技创新保障。对公共服务平台建设运营主体购置EDA设计工具软件、芯片IP授权、集成电路测试验证等设备的，采取“一企一议”方式给予补助。支持集成电路公共服务平台纳入各级“创新券”服务体系。(责任单位：集成电路筹备组)

(二) 支持集成电路设计企业发展，对开展多项目晶圆(MPW)流片的集成电路企业，按 MPW 直接费用的 80%（高校或科研院所按 90%）给予补助，对采用全掩膜工程产品流片的，按照其每款产品首次工程流片费用（掩膜版费及流片加工费）的 30%给予补助，单个企业年度最高补助 400 万元；对利用经认可的集成电路生产线流片的企业，按首次工程流片费用（含 IP 授权或购置费、掩膜版费及流片加工费等）的 40%给予补助，单个企业年度最高补助 500 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

(三) 对购买 IP 开展高端芯片研发、先进或特殊工艺芯片研发的集成电路企业，按 IP 购买直接费用的 50%给予补助，单个企业年度最高补助 250 万元；对通过第三方 IC 设计平台实行 IP 复用（知识产权共享）、共享设计工具软件或进行测试分析的集成电路企业，按实际产生费用的 55%给予补助，单个企业年度最高补助 150 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

(四) 对首次获得国家集成电路设计企业称号的集成电路企业奖励 100 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

(五) 对集成电路企事业单位承担实施并列入国家级、省级科技计划项目，按上级扶持资金额的 100%、50%配套。对高新技术企业、省实验室、省级（含）以上（企业）重点实验室、省级（含）以上新型研发机构实施并列入省级科技计划项目，按上级扶持资金额的 100%配套。以上资金配套最高 100 万元。（责任单位：科技局）

(六) 鼓励集成电路企业创建各类研发平台，新认定为国家级、省级企业技术中心（工业和信息化类）、工程研究中心、重点（企业）实验室、技术创新中心、新型研发机构、行业技术研发中心、（企业）工程技术研究中心、科技成果产业化基地、

产学研合作示范基地、工业设计中心、技术创新示范企业分别一次性奖励 150 万元、50 万元。对新认定的省级制造业创新中心牵头单位一次性奖励 50 万元，新认定的国家级制造业创新中心按照国家、省有关要求给予政策配套。（责任单位：发改局、科技局、工信局）

（七）鼓励集成电路企业在晋江辖区内的高校、科研院所、市级创新平台内联合共建实验室，对企业出资新购研发仪器设备的按实际费用的 30% 给予补助，最高补助 500 万元（以正式发票和实物为准）。鼓励集成电路企业与高校、科研院所开展产学研合作，对技术开发项目（需通过技术合同认定登记）实施完成后，按照企业实际出资金额的 20% 给予补助，单个项目最高补助 50 万元，单个企业最多申报 2 项。（责任单位：科技局）

（八）对首次认定和重新认定的集成电路高新技术企业，分别给予 20 万元、10 万元奖励。（责任单位：科技局）

（九）鼓励集成电路企业通过中国（泉州）知识产权保护中心进行专利预审和维权援助。对获得国内、外发明专利的集成电路企业按照我市专利相关政策进行奖励。鼓励集成电路企业加强专利保护和运用，对列入国家级、省级知识产权示范（优势）企业的分别给予 20 万元、10 万元奖励。（责任单位：市场监管局）

（十）对举办国际性、全国性集成电路科技类论坛、展会等，分别按实际费用的 50%、30% 给予承办机构一次性补助，单场（次）最高分别补助 100 万元、50 万元。（责任单位：集成电路筹备组）

## 五、人才优待政策

（一）经认定的集成电路优秀人才（以下简称“优秀人才”）

按第一至第七层次发放工作津贴或交通补贴，工作津贴分别为 15000、12000、8000、5000、3000、1000、500 元/人·月，交通补贴分别为 15000、13000、11000、9000、6000、3000、1000 元/人·次。（责任单位：集成电路筹备组）

（二）经我市申报并成功入选国家重点联系专家、国家万人计划、福建省百人计划、福建省台湾百人计划的优秀人才，分别按国家级资助额度的 100%、省级资助额度的 50% 给予配套经费资助。各项配套经费资助累计最高 200 万元。（责任单位：组织部）

（三）第一至第四层次人才常年在我市工作并连续缴交社会保险及个税、在我市没有自有住房且未曾享受过我市住房优惠政策的，可申请租购超高端人才社区或高端人才社区人才房，在优惠面积内享受房租补助和购房补助。第一至第四层次人才最高优惠面积分别为 300 平方米、250 平方米、200 平方米、150 平方米。房租补助按合同租金的 50% 发放。为企业服务满 5 年（时间可累计）且承租满 5 年的，根据个人意愿可申请购买所租住房，按购房时房产评估价的 40% 与 5 年个人支付房租之和给予购房补助。

在我市其他社区购置商品房的，第一至第七层次分别按 100 万元、60 万元、30 万元、20 万元、15 万元、10 万元、5 万元 给予购房补贴，分三年兑现。购房补贴与上述人才房政策不重复享受。（责任单位：集成电路筹备组）

（四）根据调查摸底情况，每年单列安排公办优质中小学和幼儿园学位，专项用于保障优秀人才子女就学，第一至第四层次及取得博士学位的优秀人才，其子女自主选择我市公办学校就读，第五至第七层次优秀人才的子女由市教育局统筹就近安

排入学；优秀人才的子女就读我市国际（双语）学校的，第一至第四层次按实缴学杂费的30%补助，第五至第七层次分别按实缴学杂费的20%、15%、10%补助。（责任单位：集成电路筹备组、教育局）

（五）优秀人才在我市公立医院就医，可享受绿色通道、先诊疗后付费特别服务；已参加医疗保险的，在扣除医疗保险报销部分后按30%补助，第一至第七层次优秀人才年度最高补助分别为25万元、20万元、15万元、10万元、5万元、3万元、1万元。（责任单位：集成电路筹备组、医保局、卫健委）

（六）鼓励有资质的第三方培训机构及院校独立或联合集成电路企业开展系统性的集成电路培训业务，根据学员入职集成电路企业情况，对培训主体按2000元/人给予补助，单个培训主体每年最高补助30万元。（责任单位：集成电路筹备组）

（七）鼓励集成电路企业与院校在“订单班”、“现代学徒制”、“二元制”等人才培养方面进行合作，按企业培训费的30%给予企业补助，单个企业每年最高补助50万元。（责任单位：集成电路筹备组）

## 六、附则

（一）本意见未列的特别项目及其他事宜，采取“一企一议”的办法报市委、市政府研究确定；已获得“一企一议”重大项目扶持措施的企业不再享受本意见中的相关扶持政策。

（二）除特别规定外，同一企业（或个人）获多层级认定或奖励的，按最高等次享受本级政策，获同级别多次认定或奖励的不予重复享受；同一企业（或个人）符合我市多项政策条款或性质相似条款的，按最高标准奖励。

（三）本意见所指投资额均不含政府的补助或奖励；新引进

集成电路企业指本意见生效后签订项目投资协议的企业。

(四) 科研鼓励政策部分的第(五)、(六)、(七)、(八)、(九)项政策，按照当年度的《晋江市大力推进科技创新能力建设的若干措施》由相关责任单位负责兑现。

(五) 其他半导体领域企业参照本意见执行。

(六) 本意见有效期三年，自公布之日起实施。2021年10月12日起至公布之日期间参照执行。

(七) 本意见由泉州半导体高新技术产业园区管委会晋江分园区办事处会同晋江市发改局、工信局、科技局等有关部门负责解释并制定具体《操作程序》。

- 附件：1. 集成电路重点鼓励业态目录  
2. 晋江市集成电路产业优秀人才认定标准  
3. 晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定办法

晋江市人民政府

2022年1月29日

(此件主动公开)

## 附件 1

# 集成电路重点鼓励业态目录

## 一、集成电路制造类

### (一) 集成电路制造

1. 内存产品制造线（核心项目）：利基型内存制造、高端内存制造

2. 逻辑 IC 产品制造线

### (二) 集成电路封测

1. 内存封测

2. TSV（硅穿孔技术）

3. SIP（系统级封装）

4. WL-CSP（晶圆级封装）

5. BGA（球栅阵列封装）

6. Flip chip（倒片封装）

7. 其他先进封装

### (三) 集成电路设计

1. 内存相关：内存控制器设计

2. 智能穿戴装置（鞋服）/消费电子终端方面：包括网络芯片设计、RFID 设计、MEMS 传感器设计、物联网芯片设计、电源管理芯片设计、MCU 及 ECU 设计

3. 光电显示模组方面：面板驱动设计、触控设计、高速接口设计、LED 芯片设计

## **二、集成电路配套类**

### **(一) 集成电路装备**

1. 制造设备：光刻机、刻蚀机、离子注入机、气相沉积设备、清洗设备、洗净/干燥装备、涂布/显影装备、切割机、原子沉积设备、CMP 研磨装备
2. 封装设备：光刻机、打线机、绑定机、清洗设备
3. 检测设备：线宽和缺陷检测电镜、光学检测仪器、真空泵、检漏仪、内存测试机、逻辑测试装备、探针台

### **(二) 集成电路材料**

1. 制造材料：掩膜版及掩膜版基材、电子特气、硅晶圆、抛光材料、高纯度化学试剂、光刻胶及配套试剂、靶材、支撑环
2. 封装材料：封装基板、塑封料、引线框架、键合丝、粘合材料

## **三、集成电路应用终端类**

- (一) 智能穿戴产品（包括智能衣、感应鞋、智能运动健身器械、智能帽、智能袜、智能行李箱等）
- (二) 智能装备（包括数控机床等）
- (三) 智能汽车（包括汽车电子、无人车、车联网等）
- (四) 物联网
- (五) 通讯设备

## 附件 2

# 晋江市集成电路产业优秀人才认定标准

晋江市集成电路产业优秀人才分为七层次，符合下列任一条目的人才可认定为我市集成电路产业对应层次优秀人才。对于同时符合多个层次或条目的，按从高从优不重复原则确定优秀人才层次。对于未涵盖的其他相应层次的人才，由福建省集成电路产业园区建设筹备工作组人才科技组会相关部门组织专家组或委托专业机构评定后报福建省集成电路产业园区建设筹备工作组批准可纳入相应优秀人才层次。

## 一、第一层次

(一) 国际顶级知名奖项获得者：诺贝尔奖、中国国家最高科学技术奖、美国国家科学奖章（总统科学奖）、美国国家技术创新奖章、法国全国科研中心科研奖章、英国皇家金质奖章、科普利奖章、图灵奖、菲尔兹奖、沃尔夫奖、阿贝尔奖、克拉福德奖、日本国际奖、京都奖、邵逸夫奖；

(二) 国际电气和电子工程师协会（IEEE）奖章获得者；

(三) 国际电气和电子工程师协会会士（IEEE Fellow）、国际计算机学会会士（ACM Fellow）、国际工程技术学会会士（IET Fellow）、美国物理学会会士（APS Fellow）；

(四) 美国工程界三大最高奖项：德雷铂奖（Charles Stark Draper Prize）、拉斯奖（Fritz J. and Dolores H. Russ Prize）、戈登奖（Bernard M. Gordon Prize）获得者；

(五) 中国、美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、比利时、瑞士、奥地利、荷兰、西班牙、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、以色列、印度、乌克兰、新

新加坡、韩国等的科学院院士、工程院院士（即成员 member 或高级成员 fellow，见中国科学院国际合作局网站 <http://www.bic.cas.cn>），台湾中央研究院院士；

（六）国家重点联系专家长期项目、创业人才项目、外国专家项目、顶尖人才与创新团队项目的入选者，国家“万人计划”杰出人才、领军人才；

（七）中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者；

（八）中国机械工程学会科技成就奖、青年科技成就奖获得者；

（九）中国机械工业科学技术奖特等奖前 3 位完成人；

（十）近 10 年，获得以下奖项之一者：

1. 国家自然科学奖、技术发明奖一等奖前 3 位完成人，国家科技进步奖特等奖前 5 位完成人，国家科技进步奖一等奖前 3 位完成人，省科学技术奖重大贡献奖获得者；

2. 中国青年科学家奖；

3. “长江学者”称号获得者。

（十一）近 10 年，担任以下职务之一者：

1. 原国家“973 计划”项目首席科学家；

2. 原国家“863 计划”项目首席科学家；

3. 原国家科技支撑（攻关）计划项目负责人；

4. 国家科技重大专项专家组组长，且项目（课题）通过验收；

5. 国家重点研发计划重点专项项目组负责人；

6. 国家级人工智能或机器人领域大赛专家组组长；

7. 国家重点学科、重点实验室、国家级企业技术中心、工程技术研究中心首席专家、国家制造业创新中心技术委员会主任，且年薪高于 6 倍以上；

8. 八国集团成员国（美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大、俄罗斯）国家级重大科技计划项目负责人或首

席科学家。

(十二) 近 10 年, 在《Nature》、《Science》或《Reviews of Modern Physics》杂志上以第一作者或通讯作者发表集成电路相关论文者;

(十三) 在全球前 25 大半导体公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者;

(十四) 在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封测、装备等领域全球前 5 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者;

(十五) 近 10 年, 担任过世界 500 强企业及中国 50 强企业总部董事长(或总裁)、首席执行官、首席技术官(技术研发部门第一负责人)、首席设计官(工艺设计部门第一负责人)、首席质量官。

## 二、第二层次

(一) 国际电气和电子工程师协会 (IEEE) 技术奖获得者;

(二) 国家重点联系专家创新人才短期项目、青年项目、新疆西藏项目入选者;国家“万人计划”领军人才(包括科技创新领军人才、科技创业领军人才和百千万工程领军人才)、国家“万人计划”青年拔尖人才、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才;

(三) 国家杰出青年基金获得者、中国青年科技奖获得者、中国青年女科学家奖、享受国务院政府特殊津贴人员、全国优秀科技工作者、福建省引才“百人计划”入选者(含团队带头人)、福建省引进台湾高层次人才“百人计划”入选者;

(四) 中国机械工业科学技术奖一等奖前 2 位完成人;

(五) 近 10 年, 获得以下奖项之一者:

1. 国家自然科学奖、技术发明奖二等奖前 3 位完成人, 国

家科技进步奖二等奖第 1 完成人；

2. 国际发明展览会金奖第 1 完成人，同时是国家科技进步奖二等奖第 2、3 完成人；
3. 中国专利金奖前 3 位专利发明人（设计人）；
4. 全国科技工作者创新创业大赛金奖项目前 3 位完成人；
5. 美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大科学基金杰出青年类资助奖之一者；
6. 全国质量奖个人奖（中国杰出质量人）；
7. 泉州杰出人才奖。

（六）近 10 年，担任以下职务之一者：

1. 原国家“973 计划”项目承担研究任务的项目专家组成员；
2. 原国家“863 计划”领域主题专家组副组长、召集人；
3. 国家科技重大专项专家组副组长、项目（课题）组长，且项目（课题）通过验收；
4. 国家重点研发计划重点专项项目组副组长；
5. 国家自然科学基金重大项目资助的项目主持人、国家自然科学基金创新研究群体项目的项目负责人、国家重大科研仪器研制项目的项目负责人，且项目已结题；
6. 国家实验室主任、学术委员会主任，国家重点实验室主任、学术委员会主任，国家工程实验室主任、国家工程研究中心主任、国家工程技术研究中心主任、国家能源研发（实验）中心主任、国家级质检中心主任，且年薪高于 6 倍以上；国家制造业创新中心技术委员会副主任，且年薪高于 4 倍以上；
7. 八国集团成员国（美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大、俄罗斯）国立研究所所长、副所长、首席研究员或国家实验室主任、副主任、首席研究员；
8. 国际著名学术组织副主席、国际标准化组织（ISO）标

样委员会委员；

9. 国际高水平科技期刊（《期刊分区》一、二区）正、副总编（主编）。

（七）在全球前 25 大半导体公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（八）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 5 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（九）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球排名 6-10 的公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十）在集成电路材料、电子设计自动化（EDA）工具软件、硅智财（SIP）全球前 5 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

（十一）担任过世界 500 强企业及中国 50 强企业总部副董事长、副总裁、副总经理或总部直属一级子公司（大洲级区域部门）主要负责人 3 年以上者；

（十二）在世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学获评教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十三）“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

（十四）取得“985 工程”高校和中国科学院大学博士研究生导师资格 3 年以上且取得正高级专业技术职务者，并从事集成电路相关研究或教学者；

### 三、第三层次

（一）科技部创新人才推进计划入选者、国家产业技术体系

岗位专家、“新世纪百千万人才工程”省级人选、省部级有突出贡献的中青年专家、省（含副省级市）级以上优秀专家、省特支人才“双百计划”、省产业人才高地领军人才、省杰出青年科学基金获得者；

（二）中国机械工业科学技术奖二等奖第1位完成人；

（三）近10年，获得以下奖项之一者：

1. 国家科技进步奖二等奖第2、3位完成人，省科学技术突出贡献奖，省级科学技术进步奖、技术发明奖、自然科学奖一等奖前3位完成人；

2. 国际发明展览会金奖第2、3完成人或国际发明展览会银奖第1完成人，且同时符合以下条件之一：①省科技进步奖二等奖前3位完成人及以上，②取得正高级专业技术资格，③取得博士学历；

3. 中国专利优秀奖；省级专利金奖或特等奖、一等奖；

4. 中国人民解放军科学技术进步奖一等奖前3位完成人；

5. 全国科技工作者创新创业大赛银奖项目前3位完成人；

6. 国家部委主办的创新创业大赛行业总决赛特等奖的获奖项目核心团队前3位完成人，国家部委主办的创新创业大赛行业总决赛一等奖的获奖项目核心团队第1负责人；

7. 台湾工业总会、商业总会、工商协进会、中小企业总会、工业协进会、电电公会等六大工商团体评选或授予的最高奖项（行业公认奖项）；

8. 中国科学院“百人计划”入选者。

（四）近5年，担任以下职务之一者：

1. 原国家“973计划”项目首席科学家助理、课题组第1负责人，且课题通过结题验收；

2. 原国家“863计划”重大项目或重大项目首席专家，且项

目通过验收；

3. 原国家“863 计划”专题组组长、副组长，且专题通过验收；
4. 原国家科技支撑（攻关）计划课题第 1 负责人且课题通过结题验收；
5. 国家科技重大专项专家组成员、项目（课题）第 1 副组长、分课题组长，且项目（课题）通过验收；
6. 国家重点研发计划重点专项任务（或课题）负责人；
7. “国家软科学研究计划”重大项目第 1 负责人且项目通过验收；
8. 科技部国际科技合作计划项目中方项目第 1 负责人且项目通过验收；
9. 国家自然科学基金的重点项目、重大研究计划项目、重点国际（地区）合作研究项目、组织间国际（地区）合作与交流项目、联合基金或优秀青年科学基金项目资助的项目总负责人（不含子项目），且项目通过结题验收；
10. 国家重点实验室、国家工程实验室、国家级企业技术中心、国家工程研究中心、国家工程技术研究中心、国家能源研发（实验）中心、国家级质检中心前 2 位副主任或工程学术（技术）委员会主任、国家能源研发（实验）中心学术委员会主任，且年薪高于 4 倍以上；
11. 全国专业标准化技术委员会副主任委员；参与国家标准制（修）订排名第 2 位起草人；行业标准制（修）订排名第 1 位起草人；
12. “闽江学者”特聘教授、“桐江学者”特聘教授入选者，并从事集成电路相关研究或教学者；
13. 高等院校国家重点学科带头人、国家精品课程负责人、教育部“211 工程”高校国家重点学科博士生导师，并从事集成电

路相关研究或教学者；

14. “工信部制造业单项冠军产品”第 1 研发人员。

(五)在全球前 25 大半导体公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(六)在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封测、装备等领域全球前 5 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 7 年以上者；

(七)在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封测、装备等领域全球排名 6-10 的公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(八)在集成电路材料、电子设计自动化 (EDA) 工具软件、硅智财 (SIP) 全球前 5 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(九)在集成电路设计、制造、封测等领域大陆或台湾前 10 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

(十)在集成电路装备、材料等领域大陆或台湾前 5 大公司担任副总经理、副总裁或首席科学家以上职务累计 5 年以上者；

(十一)担任过世界 500 强企业及中国 50 强企业总部副董事长、副总裁、副总经理或总部直属一级子公司（大洲级区域部门）主要负责人 1 年以上者；

(十二)在世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学获评副教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

(十三)在世界大学排名 201-500 名的学校获评教授，并从事集成电路相关研究或教学者；

(十四)取得“985 工程”高校和中国科学院大学硕士研究生导师资格 3 年以上且取得正高级专业技术职务任职资格，并从

事集成电路相关研究或教学者；

(十五) 取得博士学位，且近 5 年在期刊分区表中列入大类一区的学术期刊上以第一作者或通讯作者发表 2 篇以上集成电路相关论文者。

#### 四、第四层次

(一) 国际电气和电子工程师协会 (IEEE)、国际计算机学会 (ACM)、国际工程技术学会 (IET)、美国物理学会 (APS) 等国际知名学会高级会员或资深会员；

(二) 中国机械工业科学技术奖三等奖第 1 位完成人；

(三) 近 5 年，获得以下项目之一者：

1. 省级科学技术进步奖、技术发明奖、自然科学奖二等奖前 3 位完成人、三等奖第 1 位完成人，地市级科学技术奖一等奖前 3 位完成人；

2. 国际发明展览会银奖第 2、3 完成人或国际发明展览会铜奖第 1 完成人，且同时符合以下条件之一：①省科技进步奖三等奖前 3 位完成人及以上，②取得副高级以上专业技术职务任职资格，③取得国家一级职业资格；

3. 省级专利二、三等奖前 3 位专利发明人（设计人），地市级专利金奖或一等奖前 3 位专利发明人或设计人；

4. 中国人民解放军科学技术进步奖二等奖前 3 位完成人、三等奖第 1 位完成人；

5. 全国科技工作者创新创业大赛铜奖项目前 3 位完成人；

6. 国家部委主办的创新创业大赛行业总决赛二、三等奖的获奖项目核心团队的第 1 负责人，获得福建省创新创业大赛总决赛一等奖的获奖项目核心团队的第 1 负责人；

7. 福建青年科技奖；

8. 福建省优秀科技工作者。

(四) 近 5 年, 担任以下职务之一者:

1. 原国家“973 计划”课题组第 2、3 负责人, 且课题通过结题验收;
2. 原国家“863 计划”课题组组长、副组长, 子课题负责人, 且课题通过结题验收;
3. 原国家科技支撑(攻关)计划课题第 2、3 负责人, 且课题通过结题验收;
4. 国家科技重大专项分课题前 2 位副组长, 且项目(课题)通过验收;
5. 国家重点研发计划专题负责人;
6. “国家软科学研究计划”面上项目第 1 负责人, 且课题通过结题验收;
7. 科技部国际科技合作计划项目中方主要参加人员前 3 位, 且完成项目通过验收;
8. 国家自然科学基金年度项目、青年科学基金项目资助的项目第 1 负责人, 且项目通过结题验收;
9. 省部级工程实验室主任、学术委员会主任, 省部级(重点)实验室主任、学术委员会主任, 省部级工程研究中心主任、省级企业技术中心主任、省级制造业创新中心技术委员会主任, 且年薪高于 4 倍以上;
10. 全国专业标准化技术委员会分技术委员会主任委员;
11. 国家级服务型制造示范企业、国家级服务型制造示范项目实施主体企业总经理, 国家级服务型制造示范平台负责人、省级服务型制造公共服务平台负责人, 省级中小企业公共服务示范平台运营负责人、省级小微企业创业创新示范基地运营负责人, 且年薪高于 4 倍以上;
12. 教育部“211 工程”高校国家重点学科教授或研究员, 并

从事集成电路相关研究或教学者；

13. 福建省高校新世纪优秀人才计划入选者，并从事集成电路相关研究或教学者；

14. “省级制造业单项冠军产品”第 1 研发人员。

(五) 在全球前 25 大半导体公司技术研发、工程部门、管理部门担任经理、功能主管、主任工程师、资深工程师、高级工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(六) 在集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封测、装备等领域全球前 10 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(七) 在集成电路材料、电子设计自动化 (EDA) 工具软件、硅智财 (SIP) 全球前 5 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(八) 在集成电路设计、制造、封测等领域大陆或台湾前 10 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(九) 在集成电路装备、材料等领域大陆或台湾前 5 大公司担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

(十) 担任过世界 500 强企业或中国 50 强总部一级部门负责人或与之级别相当的专业技术人员、总部直属一级子公司(大洲级区域部门)副总或与之级别相当的专业技术人员等职务 3 年以上者；

(十一) 取得“985 工程”高校和中国科学院大学硕士研究生导师资格 3 年以上且取得副高级专业技术职务任职资格，并从事集成电路相关研究或教学者；

(十二) 博士后出站留 (来) 晋江创业或工作者；

(十三) 晋江市博士后科研工作站在站博士后;

(十四) 取得世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学的博士学位，所学专业学科门类为理学、工学，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作者；

(十五) 取得正高级专业技术职务任职资格者。

## 五、第五层次

(一) 近 5 年，获得以下奖项之一者：

1. 省级科学技术进步奖、技术发明奖、自然科学奖三等奖第 2、3 位完成人，地市级科学技术奖二等奖前 2 位完成人、三等奖第 1 位完成人；

2. 国际发明展览会铜奖第 2、3 完成人，且同时符合以下条件之一：①地市级科技进步奖三等奖前 3 位完成人及以上，②取得副高级以上专业技术任职资格，③取得国家一级以上职业资格；

3. 地市级专利银奖、优秀奖或二、三等奖前 3 位专利发明人或设计人；

4. 中国人民解放军科学技术进步奖三等奖第 2 位完成人；

5. 福建省创新创业大赛总决赛二等奖的获奖项目核心团队的第 1 负责人。

(二) 近 5 年，担任以下职务之一者：

1. 省部级（重点）实验室、学术委员会、省部级工程实验室、省部级工程研究中心、省级企业技术中心、省级制造业创新中心技术委员会副主任，且年薪高于 2 倍以上；

2. 全国专业标准化技术委员会分技术委员会副主任委员；

3. 担任国家级服务型制造示范企业、国家级服务型制造示范项目实施主体企业、省级服务型制造示范企业总经理，省级服务型制造示范平台负责人，且年薪高于 2 倍以上；

4. 省级学科（教学）、专业带头人，并从事集成电路相关研究或教学者；省级精品在线开放课程、共享课程负责人且项目通过验收，并从事集成电路相关研究或教学者。

（三）在集成电路设计、制造、集成器件制造（IDM）、封测、装备等领域全球前 10 大公司技术研发、工程部门、管理部门担任经理、功能主管、主任工程师、资深工程师、高级工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（四）在集成电路材料、电子设计自动化（EDA）工具软件、硅智财（SIP）全球前 5 大公司技术研发、工程部门、管理部门担任经理、功能主管、主任工程师、资深工程师、高级工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（五）在集成电路设计、制造、封测等领域大陆或台湾前 10 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（六）在集成电路装备、材料等领域大陆或台湾前 5 大公司担任二级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应职务以上累计 5 年以上者；

（七）取得国家一级职业资格的技术类人员或经全国统考取得国家最高等级职业资格的管理类人员，且从事职业资格所在领域工作 2 年以上，年薪高于 2 倍以上；

（八）取得博士学位者；

（九）取得世界大学排名前 200 名学校、中国科学院大学的硕士学位，所学专业学科门类为理学、工学或相关国家部委支持（筹备）建设示范性微电子学院的硕士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作者；

（十）取得副高级专业技术职务任职资格者。

## 六、第六层次

(一) 在国家鼓励的集成电路企业担任一级部门的部门负责人、技术负责人、总工程师或其他相应科研技术职务以上累计 5 年以上者；

(二) 取得国家一级职业资格的技术类人员或经全国统考取得国家最高等级职业资格的管理类人员，且从事职业资格所在领域工作 2 年以上，年薪高于 1 倍以上；

(三) 取得硕士研究生学位者；

(四) 取得世界大学排名前 500 名学校的学士学位，所学专业学科门类为理学、工学，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作者；

(五) 取得“985 工程”高校、中国科学院大学、台湾大学、台湾清华大学、台湾交通大学、台湾成功大学、台湾中央大学、台湾中山大学、香港大学、香港科技大学、香港中文大学、香港城市大学、香港浸会大学、香港理工大学、澳门大学等院校的理学、工学学士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作者；

(六) 取得相关国家部委支持（筹备）建设示范性微电子学院的学士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作者。

## 七、第七层次

(一) 取得国家二级职业资格的技术类人员或经全国统考取得国家二级职业资格的管理类人员，且从事职业资格所在领域工作 2 年以上，年薪高于 1.5 倍以上；

(二) 取得国家相关部委发布的“双一流”建设高校及台湾中正大学、台湾中兴大学、台湾科技大学、台湾元智大学、台北科技大学、台湾阳明大学、台湾长庚大学等院校理学、工学学位或“双一流”建设学科名单所属学科的理学、工学学士学位，且从事集成电路科研、技术、工程相关工作者；

(三) 在我市集成电路企业从事集成电路科研、技术、工程相关工作累计5年以上，且符合以下条件之一者：

1. 取得全日制学士学位，所学专业学科门类为理学、工学；
2. 现担任我市集成电路企业技术研发、工程部门功能主管或其他相应职务以上。

## 说 明

一、本标准中所有奖项、荣誉、职称等的获得都必须源于集成电路领域的成就与贡献；

二、国际电气和电子工程师协会（IEEE）奖章包括：

IEEE Medal of Honor

IEEE Alexander Graham Bell Medal

IEEE Edison Medal

IEEE James H. Mulligan, Jr. Education Medal

IEEE Medal for Environmental and Safety Technologies

IEEE Founders Medal

IEEE Richard W. Hamming Medal

IEEE Medal for Innovations in Healthcare Technology

IEEE Jack S. Kilby Signal Processing Medal

IEEE/Royal Society of Edinburgh (RSE) Wolfson James Clerk Maxwell Award

IEEE Jun-ichiNishizawa Medal

IEEE Robert N. Noyce Medal

IEEE Dennis J. Picard Medal for Radar Technologies and Applications

IEEE Medal in Power Engineering

IEEE Simon Ramo Medal

IEEE John von Neumann Medal

IEEE Honorary Membership

三、国际电气和电子工程师协会（IEEE）技术奖项包括：

IEEE Biomedical Engineering Award

IEEE CledoBrunetti Award  
IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Award  
IEEE Control Systems Award  
IEEE Electromagnetics Award  
IEEE James L. Flanagan Speech and Audio Processing Award  
IEEE Fourier Award for Signal Processing  
IEEE Andrew S. Grove Award  
IEEE Herman Halperin Electric Transmission and Distribution Award  
IEEE Masaru Ibuka Consumer Electronics Award  
IEEE Internet Award  
IEEE Reynold B. Johnson Information Storage Systems Award  
IEEE Richard Harold Kaufmann Award  
IEEE Joseph F. Keithley Award in Instrumentation and Measurement  
IEEE Gustav Robert Kirchhoff Award  
IEEE Leon K. Kirchmayer Graduate Teaching Award  
IEEE Koji Kobayashi Computers and Communications Award  
IEEE William E. Newell Power Electronics Award  
IEEE Daniel E. Noble Award for Emerging Technologies  
IEEE Donald O. Pederson Award in Solid-State Circuits  
IEEE Frederik Philips Award  
IEEE Photonics Award  
IEEE Emanuel R. Piore Award  
IEEE Judith A. Resnik Award  
IEEE Robotics and Automation Award

IEEE Frank Rosenblatt Award

IEEE David Sarnoff Award

IEEE Marie Skłodowska-Curie Award

IEEE Innovation in Societal Infrastructure Award

IEEE Charles Proteus Steinmetz Award

IEEE Eric E. Sumner Award

IEEE Nikola Tesla Award

IEEE Kiyo Tomiyasu Award

IEEE Transportation Technologies Award

IEEE Frederik Philips Award

四、“世界 500 强”即美国《财富》杂志每年评选的“全球最大 500 家公司”，“中国 50 强企业”即由中国与全球化智库(CCG)研究编写、社科院社科文献出版社出版的企业国际化蓝皮书《中国企业全球化报告》中综合评选出的“中国企业全球化 50 强”；

五、国际著名学术组织包括：电气与电子工程师学会（美国）—IEEE( The Institute of Electrical And Electronics Engineers )、电气工程师学会（英国）—IEE ( The Institutions of Electrical Engineers )、国际工程技术学会—IET ( The Institution of Engineering and Technology )、美国物理学会—APS ( American Physical Society )、美国计算机协会—ACM ( Association for Computing Machinery );

六、全球前 25 大半导体公司，集成电路设计、制造、集成器件制造 (IDM)、封测、装备等领域全球前 10 大公司和大陆或台湾前 10 大公司，及集成电路材料（硅片、光罩材料等）、电子设计自动化 (EDA) 工具软件、硅智财 (SIP) 全球前 5 大公司名单参照国际级研究机构 IC Insights、Trendforce、Gartner、IDC、IHS 或中国半导体行业协会发布的最近年度企业排名。在

此类公司总部任职人员，按照本标准认定人才类别；在此类公司的分公司、全资子公司、控股子公司或地区总部任职人员按照本标准降低一级认定人才类别；

七、国际发明展览会包括：法国巴黎国际发明展览会、欧盟斯特拉斯堡国际发明展览会、德国纽伦堡国际发明展览会；

八、前文“从事职业资格所在领域工作相应年限以上”，均指取得相应职业资格证书并完成注册、登记等执业准入要求后的工作年限；

九、职业资格参照国家人社部网站发布的国家职业资格目录清单；

十、世界大学排名参照英国泰晤士高等教育发布的最近年度高等教育世界大学排名；

十一、期刊分区参照中国科学院发布的论文发表当年度期刊分区情况；

十二、前文“年薪高于相应倍数以上”，如无特别说明，均指我市用人单位连续1年支付年薪高于我市上一年度城镇单位在岗职工平均工资相应倍数以上；

十三、专业学科门类认定参考国家相关部委发布的最新版《学位授予和人才培养学科目录》及相关规定；

十四、在站博士后实际服务单位与省人社厅开具的介绍信单位不符的，需提供所在市委组织部或人社局出具的相关事实函件；

十五、“985工程”高校名单（39所）：北京大学、中国人民大学、清华大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、南开大学、天津大学、大连理工大学、东北大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、

东南大学、浙江大学、中国科学技术大学、厦门大学、山东大学、中国海洋大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、中南大学、国防科学技术大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、兰州大学；

十六、支持(筹备)建设示范性微电子学院的高校名单、“211工程”高校名单、“双一流”建设高校及学科名单、国家鼓励的集成电路企业名单以相关部门发文公布的最新版为准；

十七、本标准中取得相关国家部委支持（筹备）建设示范性微电子学院的学士学位或国家相关部委发布的“双一流”建设高校学位或“双一流”建设学科名单所属学科学位的，均应为国家部委相关政策颁布实施后取得的；

十八、本标准中的“以上”包括本级（本数）；

十九、认定条款中“近5年、近10年等年限”，以申报时间为起始时间，往前推算5年或10年。如申报时间为2021年5月20日，则近5年则为2016年5月21日至2021年5月20日；

二十、本标准中通过个人荣誉、工作年限、学位证书等内容认定为我市集成电路产业优秀人才的，相关佐证不可于技术研发人才积分评定中重复使用；

二十一、本标准自公布之日起开始实施，2021年10月12日起至公布之日期间参照执行。

## 附件 3

# 晋江市集成电路产业技术研发人才 积分评定办法

## 一、总则

(一) 为贯彻落实中央、省委关于深化人才体制机制改革的实施意见和泉州市人才“港湾计划”有关精神，深入实施晋江市“人才强市”战略，加快聚集集成电路产业人才，优化集成电路产业人才评价体系，根据我市集成电路产业实际，特制定本办法。

(二) 晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定工作在福建省集成电路产业园区建设筹备工作组（以下简称“集成电路筹备组”）领导下，由集成电路筹备组人才科技组负责组织实施。

(三) 集成电路产业技术研发人才积分评定工作应遵循客观公正、公开透明、科学评价、程序规范、高效便民的原则。

## 二、适用对象

本实施办法适用于在我市注册且上一年度主营业务收入1亿元以下（含1亿元，人民币）的集成电路企业技术研发人才（主营业务收入以税务申报金额为准），其中经济效益、投融资

金额、人才汇聚及社会效益中党建部分仅适用于企业股东，经济效益、投融资金额要求适用企业股东签订劳动合同并占股超过 10%（含 10%）且当年度在企业连续缴纳社会保险或个税。

### **三、积分办法**

本办法采用指标量化方式，计分项目由基础分、贡献分、资历分和一票否决项四部分组成。基础分以优秀人才初始获批认定的人才层次为加分依据，属于固定分值，不受后续人才层次晋升而变化；贡献分由人才在促进企业、行业和社会发展中取得的各项业绩组成；资历分由人才在晋服务年限和人才家庭融入晋江程度组成，其中人才在晋服务年限仅限于集成电路企业；一票否决主要是涉及违法、违纪、重大失信等行为，人才出现一票否决情形的，人才个人取消积分资格，企业出现一票否决情形的，企业股东取消积分资格。积分每年度核算一次，根据人才当年度内获得的贡献分、资历分累加后，再加上基础分计算得出总分值，根据总分值对应的人才层次给予人才晋升层次。人才通过积分评定晋升人才层次，基础分不随人才层次变更而变更，加分项不重复计算。积分项目和分值详见附件。

### **四、积分申请和审核**

（一）用人单位每年 12 月份统一为人才提出积分申请，按要求提交相关证明材料。

（二）用人单位为人才进行积分申请，并负责审核申请人提交材料的真实性，所有材料需加盖用人单位公章，如提供复印

件必要时需提供原件备查。

(三) 同一证明材料(含个人荣誉、工作年限、学位证书等)不可重复应用于人才层次认定与人才积分评定。

(四) 积分评定程序分为:①审核,由集成电路筹备组人才科技组组织对申报材料进行核定并提出拟调整人才层次意见;②公示,积分结果及调整后的人才层次在集成电路筹备组及申报企业公示5个工作日;③发布公告,经公示无异议后,发布人才层次变更公告。

(五) 申请人对人才积分审核结果有异议的,可在公示之日起5个工作日内申请复核;受理部门应当自收到复核申请之日起5个工作日内完成核查,并将复核结果告知申请人。

## 五、积分运用

人才凭所获积分认定为对应分值层次的优秀人才,可依据本意见享受相应的人才优惠政策。

## 六、监督检查

(一) 申请人或用人单位做出虚假承诺、伪造或提供虚假证明资料的,一经部门审查发现,不予纳入人才积分体系,且自造假行为被发现之日起,5年内不接受人才积分评定,并记入本市社会征信系统。构成违法犯罪的,依法追究相关法律责任。

(二) 对人才积分审核有异议的,可向受理部门申诉或提出异议,由相关部门对异议情况进行调查核实。

## 七、附则

(一) 本办法自公布之日起实施。

(二) 本办法由泉州半导体高新技术产业园区管委会晋江分园区办事处负责解释。

附件：晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定表

## 附件

# 晋江市集成电路产业技术研发人才积分评定表

| 类别  | 积分项目       | 积分标准  | 证明材料   |
|-----|------------|---|--|
| 基础分 | 集成电路产业技术人才 | 对照《晋江市集成电路产业优秀人才认定标准》，符合相应层次认定条件的：<br>第一层次人才得 6000 分；<br>第二层次人才得 4000 分；<br>第三层次人才得 2000 分；<br>第四层次人才得 1000 分；<br>第五层次人才得 500 分；<br>第六层次人才得 200 分；<br>第七层次人才得 100 分；<br>非优秀人才得 0 分。 |  |
|     | 经济效益       | 企业年度主营收入首次突破 500 万元（人民币，下同），加 50 分；<br>此后，企业年度主营收入较前一年每新增 1000 万元，再追加 50 分；<br>企业年度主营收入以企业上一年度税务申报金额为准。   |  |
| 贡献分 | 投融资金额      | (1) 企业累计吸引投资机构投资达到 500 万元（人民币，下同），加 100 分。此后，每新增吸引投资机构投资满 1000 万元，再追加 50 分；<br>(2) 个人累计投资资金达到 100 万元，加 100 分。此后，个人每新增投资满 100 万元，再追加 50 分；<br>该项累计加分上限 1000 分。<br>以投融资实际到账金额为准。      | 验资报告或市场监督管理局的内档、外档（股权变更登记）、股权转让协议、出资证明、银行电子回单、工资发放凭证等。 |
|     | 创新成果       | (1) 以第一发明人身份申请并获授权集成电路及相关领域发明专利每件加 50 分；<br>(2) 以第二发明人身份申请并获授权集成电路及相关领域发明专利每件加 20 分；<br>该项累计加分上限 500 分。   | 发明专利证书副本或国家知识产权局官网所查询到的公告。                             |

| 类别    | 积分项目  |  | 积分标准  | 证明材料  |
|-------|-------|--|---|---|
| 贡献分   | 人才汇聚  |  | (1) 企业每新引进 1 名集成电路及相关领域博士研究生员工，加 50 分；<br>(2) 企业每新引进 1 名集成电路及相关领域硕士研究生员工，加 20 分；<br>该项累计加分上限 500 分。（引进人员需常年在晋工作）  | 劳动合同/社保记录/员工学历、学位证书复印件等。                    |
|       | 社会效益  | 荣誉   | (1) 个人获得各级劳模、道德模范、先进工作者、荣誉市民、见义勇为奖及其他同等荣誉，其中：县处级的每次得 20 分，地厅级的每次得 30 分，省部级的每次得 50 分，国家级的每次得 100 分；<br>(2) 个人入选“两代表一委员”的，其中：县处级的每次得 20 分，地厅级的每次得 30 分，省部级的每次得 50 分，国家级的每次得 100 分；<br>(3) 在晋江市范围内有参与无偿献血、志愿服务、慈善捐款等活动，每项可加 2 分，每年累计加分上限 10 分。 | 荣誉证书、献血证书、志愿工时证明、获奖证书、慈善捐赠等。                |
|       |       | 党建   | 企业建立党组织机构的，加 50 分；<br>每发展一名企业党员，加 20 分。<br>该项累计加分上限 150 分。  |   |
| 资历分   | 服务年限  |  | 在晋服务年限，每在晋工作满一年加 20 分，累计加分上限 200 分。   | 社保缴交记录。                                     |
|       | 在地加分项 |  | 在晋购买住房加 20 分，配偶在晋工作加 20 分，子女在晋就学加 20 分。   | 相关佐证材料。                                     |
| 一票否决项 |       | (1) 提供虚假材料申报的；<br>(2) 个人存在刑事犯罪、违反党纪、重大失信行为的，违反意识形态十类情形的；<br>(3) 所在企业存在偷税、逃税、抗税、骗税行为受到税务部门处罚的，存在违法经营行为受到处罚的；<br>(4) 企业汇算清缴年度发生严重失信行为，较大及以上火灾事故、重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为；<br>(5) 其它不符合人才政策的情形。 |   | 由宣传、公安、法院、税务、市场监管、消防大队等部门联合核查征信情况并提供相应记录材料。 |

---

抄送：市委办、人大办、政协办、纪委办。

---

晋江市人民政府办公室

2022年1月29日印发

---